

中波红外线热像仪



应用

为科研院所及企业提供整机开发、系统集成所需高端制冷型红外核心组件。

产品特点

- ◆ 提供全密封防水或光机一体化的部件，按航空级环境适应性要求设计加工；
- ◆ 制冷式HgCdTe（碲镉汞）焦平面探测器，低噪声，高灵敏度；
- ◆ FPGA智能化图像运算处理平台，高帧频，图像清晰；
- ◆ 长焦距双视场光学系统，可大范围搜索预警和远程重点目标识别跟踪；
- ◆ 长焦距、大面阵、小像元，使系统具有极高的空间分辨率；
- ◆ 可按系统总体要求设计通讯协议。

产品功能

★可通过串口控制如下功能：

调焦、视场切换（或连续变焦）、手动背景/快门校正、白热/黑热极性转换、2倍插值实时电子放大、手动/自动图像增益/亮度调节、十字分划线显示/消隐及位置调节、图像增强/平滑/锐化、图像镜像/水平/垂直翻转以及盲元自动校正等；

★可设定地对空、地对地、天地观测全自动模式、图像效果最佳；

★系统参数自检/复位。

技术指标

探测材料	制冷式HgCdTe焦平面	像元素	640×512
像元尺寸	15 μm	工作波段	3.7 μm ~4.8 μm
图像帧频	25Hz,50Hz,100Hz	启动时间	≤6min(20℃), ≤8min(50℃)
积分时间	可调	视频输出	模拟P/N制, 数字Camera link
供电范围	标配DC+24V (DC8~42V可选)	平均功耗	≤25W
光学焦距	110~1100连续变焦, 600/150/22, 400/100		
视场角	0.69° × 0.55° ~6.9° × 5.5° (110~1100)		
	0.9° × 0.7° /3.7° × 2.9° /24.6° × 9.8° (600/150/22)		
	1.4° × 1.1° /5.5° × 4.4° (400/100)		
NETD	≤25mK		
工作温度	-40℃~+65℃	存储温度	-50℃~+70℃
通讯方式	RS232/RS422串口, 开放串口协议		
重量、尺寸	25Kg(110~1100连续变焦); 611mm x 310mm x 227mm(LxWxH)		

应用

为科研院所及企业提供整机开发、系统集成所需高端制冷型红外核心组件。

产品特点

- ◆ 提供全密封防水或光机一体化的部件，按航空级环境适应性要求设计加工；
- ◆ 制冷式HgCdTe（碲镉汞）焦平面探测器，低噪声，高灵敏度；
- ◆ FPGA智能化图像运算处理平台，高帧频，图像清晰；
- ◆ 长焦距双视场光学系统，可大范围搜索预警和远程重点目标识别跟踪；
- ◆ 长焦距、大面阵、小像元，使系统具有极高的空间分辨率；
- ◆ 可按系统总体要求设计通讯协议。

产品功能

★可通过串口控制如下功能：

调焦、视场切换（或连续变焦）、手动背景/快门校正、白热/黑热极性转换、2倍插值实时电子放大、手动/自动图像增益/亮度调节、十字分划线显示/消隐及位置调节、图像增强/平滑/锐化、图像镜像/水平/垂直翻转以及盲元自动校正等；

★可设定地对空、地对地、天地观测全自动模式、图像效果最佳；

★系统参数自检/复位。

技术指标

探测材料	制冷式HgCdTe焦平面	像元素	640×512
像元尺寸	15 μm	工作波段	3.7 μm ~4.8 μm
图像帧频	25Hz,50Hz,100Hz	启动时间	≤6min(20℃), ≤8min(50℃)
积分时间	可调	视频输出	模拟P/N制, 数字Camera link
供电范围	标配DC+24V (DC8~42V可选)	平均功耗	≤25W
光学焦距	800~80连续变焦, 600/150/22, 400/100		
视场角	0.69° × 0.55° ~6.9° × 5.5° (800~80)		
	0.9° × 0.7° /3.7° × 2.9° /24.6° × 9.8° (600/150/22)		
	1.4° × 1.1° /5.5° × 4.4° (400/100)		
NETD	≤25mK		
工作温度	-40℃ ~+65℃	存储温度	-50℃ ~+70℃
通讯方式	RS232/RS422串口, 开放串口协议		
重量	16.5Kg(800~80连续变焦); 14.8Kg (600/150/22三视场); 10.5 Kg (400/100双视场)		